



平成 26 年5月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成 25 年9月 27 日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 平成 25 年 10 月 15 日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成 26 年5月期第 1 四半期の業績(平成 25 年6月 1 日～平成 25 年8月 31 日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26 年5月期第 1 四半期	11,373	△8.1	714	2.4	692	3.7	418	3.6
25 年5月期第 1 四半期	12,370	13.8	697	△41.2	667	△40.2	403	△36.9

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26 年5月期第 1 四半期	12.50	—
25 年5月期第 1 四半期	12.06	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26 年5月期第 1 四半期	68,046	52,427	77.0
25 年5月期	66,176	52,422	79.2

(参考)自己資本 26 年5月期第 1 四半期 52,427 百万円 25 年5月期 52,422 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25 年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
26 年5月期	—	—	—	—	—
26 年5月期(予想)	—	12.00	—	12.00	24.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成 26 年5月期の業績予想(平成 25 年6月 1 日～平成 26 年5月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	22,000	△10.2	1,280	16.5	1,250	16.9	750	17.3	22.40
通期	44,500	0.8	2,400	22.8	2,400	15.0	1,400	11.8	41.81

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 有

③ 会計上の見積りの変更 : 有

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は【添付資料】3ページ「(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

26年5月期1Q	35,497,183株	25年5月期	35,497,183株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

26年5月期1Q	2,015,525株	25年5月期	2,015,453株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年5月期1Q	33,481,706株	25年5月期1Q	33,482,100株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期財務諸表	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出に持ち直しの動きが見られ企業収益が改善するなど、緩やかな回復の動きが見られました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、パソコンや薄型テレビなど民生用電子機器の需要は低調でありましたが、スマートフォンやタブレット端末の需要が堅調に推移したことから、緩やかな回復基調となりました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は113億7千3百万円と前年同四半期比8.1%の減収となり、営業利益は7億1千4百万円(前年同四半期比2.4%増)、経常利益は6億9千2百万円(同3.7%増)、四半期純利益は4億1千8百万円(同3.6%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、全体的に緩やかな回復基調となりました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、その他の取扱商品において減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して18億7千万円増加し、680億4千6百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により18億6千5百万円増加し、156億1千8百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加1千6百万円等により、524億2千7百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、経済政策の効果を背景として緩やかな景気回復の動きが見られるものの、海外景気の下振れや原材料価格の上昇などが懸念され、わが国経済は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、引き続き半導体デバイス需要の動向から目が離せない状況が続くものと予想されます。

このような経営環境のもと、当社といたしましては今後も最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。

なお、未定としておりました平成26年5月期の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。通期業績は、売上高445億円、営業利益24億円、経常利益24億円、当期純利益14億円を見込んでおります。

また、配当金につきましては、中間、期末ともに前期と同額の1株当たり12円を予定しております。これにより、年間の配当予想は前期と同様1株当たり24円となります。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更)

当社はシリコンウエハー加工設備（再生ウエハー加工設備を除く）について、設備の使用実態調査の結果を反映して当第1四半期会計期間における取得設備より、耐用年数を5年に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

シリコンウエハー加工設備（再生ウエハー加工設備を除く）については、通常の稼働時間を超えて使用することが常態化していることから、増加償却の適用対象となりました。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,045	20,522
受取手形及び売掛金	13,256	15,792
商品及び製品	186	218
仕掛品	377	263
原材料及び貯蔵品	948	1,035
その他	780	1,956
貸倒引当金	△5	△5
流動資産合計	35,589	39,784
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	12,839	12,561
その他(純額)	12,006	12,155
有形固定資産合計	24,846	24,716
無形固定資産	984	947
投資その他の資産		
その他	4,762	2,604
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	4,755	2,598
固定資産合計	30,586	28,262
資産合計	66,176	68,046
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,481	11,553
短期借入金	100	100
未払法人税等	661	118
引当金	58	376
その他	1,604	1,670
流動負債合計	11,906	13,819
固定負債		
長期借入金	350	325
退職給付引当金	1,312	1,295
その他	184	179
固定負債合計	1,846	1,799
負債合計	13,753	15,618

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	18,147	18,163
自己株式	△3,409	△3,409
株主資本合計	52,339	52,356
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	83	71
評価・換算差額等合計	83	71
純資産合計	52,422	52,427
負債純資産合計	66,176	68,046

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成25年6月1日 至平成25年8月31日)
売上高	12,370	11,373
売上原価	11,114	10,102
売上総利益	1,255	1,270
販売費及び一般管理費	557	556
営業利益	697	714
営業外収益		
受取利息	2	2
受取配当金	2	3
その他	5	6
営業外収益合計	10	12
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	11	31
その他	28	3
営業外費用合計	40	35
経常利益	667	692
特別利益		
固定資産売却益	—	6
特別利益合計	—	6
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	0	8
特別損失合計	0	8
税引前四半期純利益	666	690
法人税、住民税及び事業税	69	95
法人税等調整額	193	176
法人税等合計	262	271
四半期純利益	403	418

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第1四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	5,487	6,882	—	12,370	—	12,370
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	—	632	632	△632	—
合計	5,487	6,882	632	13,003	△632	12,370

当第1四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年8月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	5,490	5,882	—	11,373	—	11,373
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	460	462	△462	—
合計	5,492	5,882	460	11,835	△462	11,373